

ま え が き = PVD（Physical Vapor Deposition）法は，真空中で行う成膜技術の代表的な方法であり，皮膜材料の

" * 1 4 ³ æ " ¶ w s › Ã › Ž < t Ô b {

- ・ピストンリングの内側に水冷パイプを通すことにより，従来約 500℃であった処理温度を 380℃まで低減し，処理温度の制約から従来 PVD 処理できなかった材料の適用が可能⁵⁾
- ・斜め切断チャンバ⁶⁾と，テーブルを搭載したツインドアシステムの採用により連続バッチ処理を実現し，生産性の向上とともにメンテナンス作業性も大幅に改善

1.4 インライン式 AIP 装置

バッチ式の装置に対して，初期真空排気，ワークの予熱，ボンパード，コーティング，冷却など PVD 処理の各工程をそれぞれ専用に処理（または一部共用処理）するチャンバを仕切り弁を介して連結し，ワークを順に搬

